

# Fractus

---

15.02.2006 - 13:47 Uhr

## Fractus präsentiert revolutionäre vollständig drahtlose System in Package'-Technologie auf der 3GSM 2006

Barcelona (ots/PRNewswire) -

Fractus, Vorreiter der Technologie für Fraktal-Antennen, wird auf der 3GSM 2006 in Barcelona die weltweit erste kommerziell verfügbare vollständig drahtlose System in Package'-Technologie (FWSiP) vorstellen.

Bei FWSiP handelt es sich um eine komplett drahtlose Lösung in einem Paket -jede Einheit kann damit einfach und kosteneffizient für den drahtlosen Betrieb eingerichtet werden, ohne dass Hersteller über entsprechende RF-Erfahrung verfügen müssen.

FWSiP ist die nächste Entwicklungsstufe der SiP (System in Package) Technologie, welche die meisten Funktionen eines elektronischen Systems in einem einzelnen Paket auf einer Platine (PCB, Printed Circuit Board) bereitstellt. Traditionelle drahtlose SiP-Technologie benötigte bisher immer eine separate Antennen-Komponente, was zusätzlichen Platz sowie elektronische Verbindungen und weitere Massnahmen erfordert, um RF-Interferenzen zu vermeiden.

"Die Vergangenheit der Telekommunikation war die Verbindung des Telefons mit dem Computer - die Zukunft ist die Verbindung von allen möglichen Komponenten," erklärt Tim Hillison, Direktor für den Geschäftsbereich Short-Range Wireless bei Fractus. "Zum ersten Mal können Hersteller auf einem kleinen Abschnitt der Platine jede Einheit, von der Armbanduhr bis zur Waschmaschine, für den drahtlosen Betrieb einrichten. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Technologie den Wireless-Markt revolutionieren wird."

FWSiP wird auch dazu beitragen, die Materialkosten, Komponentengrößen, Motherboard-Komplexität, Design-Kosten sowie die Markteinführungszeiten für Einheiten zu reduzieren, bei denen die Wireless-Funktionalität bereits eingebaut ist, wie z.B. bei Handys. Darüber hinaus wird diese Technologie die Implementierung von diskreten Wireless-Funktionen innerhalb von mobilen Einheiten wie Kameras und PDAs erleichtern.

Fractus wird FWSiP an Hersteller von Elektronik-Komponenten und Halbleitern lizenzieren, die damit FWSiP Wireless-Komponenten in neue oder vorhandenen Pakete und Chipsets aufnehmen können.

Die neue Fractus-Technologie ist sehr flexibel. OEM/ODMs können angeben, welche Wireless-Standards die jeweilige Einheit unterstützen soll und der Komponenten-Hersteller fügt einfach das entsprechende FWSiP auf einem vorhandenen Chipset hinzu.

Fractus wird die Leistungsfähigkeit der Technologie am Beispiel eines transparenten Bluetooth USB Dongle-Adaptors auf dem Stand J40 (Halle 2, Ebene 1) demonstrieren.

Über Fractus

Fractus entwickelt und produziert leicht zu integrierende, kostengünstige und leistungsstarke Miniatur-Mehrbandantennen für drahtlose Anwendungen. Dank der einzigartigen raumfüllenden und mehrstufigen Eigenschaften von Fraktalen, kommen Fractus-Antennen in Mobiltelefonen, drahtlosen Bluetooth(R), WLAN- und UWB-Geräten sowie Basisstationen zum Einsatz. Fractus verfügt mit 37 Patentfamilien über ein beträchtliches Portfolio an geistigem Eigentum und wurde im Jahre 2005 vom World Economic Forum zum Technologie-Pionier ernannt.

Für weitere Informationen siehe [www.fractus.com](http://www.fractus.com)

Pressekontakt:

Fractus Angela Carson +34-(93)-544-2690 [angela.carson@Fractus.com](mailto:angela.carson@Fractus.com) ,  
Fractus PR Agency Oliver Chapman +44-(0)20-8392-4050  
[fractus@axicom.com](mailto:fractus@axicom.com)

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100006789/100504470> abgerufen werden.